



AGENDA

Seminar am 22.09.2016

Hohe Zuverlässigkeit /Hochtemperaturanwendungen

- 12.30 – 13.30 Uhr Come Together mit Lunchbuffet
- 13.30 – 13.50 Uhr **Begrüßung der Teilnehmer und Vorstellung CCI Eurolam GmbH**
CCI Eurolam GmbH
Angelika Muscal - Niederlassungsleitung Deutschland
- 13.50 – 15.00 Uhr **„Vom „Grünen Brett“ zum High-Performance-Schaltungsträger“**
Miniaturisierung und Zuverlässigkeit von innovativen Leiterplatten
Fraunhofer IZM
Herr Dr. Hans Walter - Dept. Environmental and Reliability Engineering
- 15.00 – 15.45 Uhr **Through hole filling**
Hofstetter PCB AG
Herr Hans-Rüdi Fischer – Geschäftsführer
Andy Stütz – Technischer Leiter
- 15.45 – 16.15 Uhr *Kaffeepause*
- 16.15 – 17.15 Uhr **Hochtemperaturanwendungen**
➤ Wann sprechen wir von Hochtemperaturanwendungen
➤ Warum erforderlich
➤ Lösungsansätze
➤ Entwicklung auf diesem Gebiet
Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
Jörg Trodler - Global Business Unit Heraeus Electronics
- 17.15 – 17.45 Uhr **Materialien für Hochtemperaturanwendungen**
CCI Eurolam GmbH
Elke Krüger – Technical Manager Germany
- 17.45 – 18.15 Uhr **Abschlussdiskussion**